

# Willkommen bei O-Leading

Wir sind professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Einzelne Produktreihe, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir bieten schnellen Prototypservice - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Stunden Produktionszeit.

KUPFERPLATTENLÖCHER MINDEST .025 AVG, .020 MIN. LÖCHER DÜRFEN NICHT GESTROMT WERDEN

Packen Sie mit farbloser, transparenter Luftpolsterfolie, 25 Stck./Tasche, Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf die Oberseite

BITTE KLICKEN SIE DIESE FÜR WEITERE INFORMATIONEN: [Motor Power Module Hersteller China](#)

## Produktbeschreibung

### Schnelle Details

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Leading
Basismaterial/Basematerial	FR-4, Aluminium	Kupferdicke	0,5 oz-5 oz
Oberflächenveredelung	Immersiongold, OSP, bleifreies HASL	Brettstärke	0,1-5 mm
Mindest. Linie 0,2 mm breit	0,2 mm	Mindest. Zeilenabstand	0,2 mm
Farbe	blau, rot, grün, schwarz	Preis	\$ 0,1- \$ 10
anwendbar auf	LED, Handy, Klimaanlage, Waschmaschinen	Größe	0,01m3-10m3
Charakter	Industrielle Steuerungsplatine	Mindest. Lochgröße	0,2 mm 0,2 mm
Zertifikate	ISO9001, UL, RoHS, SGS	MOQ	10 stück
Q / CTN	10PCS-100PCS	design type	Kundenanforderung
Gewicht	0,01 kg bis 5 kg		

### Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen:	16 Jahre professioneller OEM Leiterplattenhersteller
Lieferung Detail:	7-12days

### 16 Jahre professionelle OEM Leiterplattenfertigung

Artikel	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Probe	Volumen	Probe	Volumen	Probe
Schichtanzahl	32	42	38	44	42	48
Min Line / Abstand (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35

Min Bohrloch Durchmesser (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Seitenverhältnis von PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Beliebige Schichtverbindung	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plattenfüllung über	JA	-	JA	-	JA	-
Mindest. Kernstärke (ohne Kupfer) (µm)	50	40	40	30	40	30
Mindest. Laser Bohrer Durchmesser (µm)	75	65	65	50	50	40
Via auf begraben Loch / gestapelt via	JA	-	JA	-	JA	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, schweres Kupfer usw.					
Embedded-Kondensator-PCB	JA	-	JA	-	JA	-
Oberflächenprozess	Bleifreies HASL, ENIG, OSP, Immersions Silber, Immersionsdose, Flash-Gold, Vergoldung mit Finger, Selektive Hartvergoldung, Abziehbare Lötmaske, Carbon-Tinte					



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[Sicherstellung hochwertiger Leiterplattenbestückung, Leiterplattenhersteller China](#)

Unser Team





Zertifizierungen



**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE**  
 Certificate No: 16118Q10347R05

**We hereby certify that**  
**O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED**  
 Credit No: 61691591-000-07-17-2  
 Registration Add: ROOM 603D 6/F HANG PONT COMMERCIAL BUILDING,31 TONKIN ST. CHEUNG SHA WAN, HK  
 Business Add: 1313 Floor 13 Fortune Building, Danstui Town Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System**  
 Which fulfills the requirements of the following standards  
 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

**Scope of certification**  
 Sales of printed circuit boards

Initial Issuance period: February 27, 2018  
 This certificate is valid during: February 27, 2018 -- February 26, 2021  
 This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First supervision and audit	Qualified mark	Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	----------------	------------------------------	----------------

The certification inspection scope shall include those products/services scopes which fall to be covered by the relevant effective administrative permission and qualification permission required by the state. The effectiveness of this certificate shall be evaluated by annual surveillance audit of CICC. The certificate shall be valid when used together with the surveillance audit conclusion. The related information of this certification can be searched at the public website of company www.cicc.com.

201726 201VZL430354 - Wiring, Printed - Component

**UL ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY**

**ZPMV2.E490354**  
**Wiring, Printed - Component**

For enhanced search functionality, please visit UL's [ULi Family of Databases](#). Click on a product designation for complete information.  
[Page Bottom](#)

**Wiring, Printed - Component**

[See General Information for Wiring, Printed - Components](#)

**O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED** E490354  
 Fortune Building, Nanheng West Road  
 Room 1313  
 Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

Cond Width		Min		Max		Min		Max		Meets	
Min	Edge	Cond	SS/Thk	Area DS/ Diam	Solder Limits	Dper	Temp	Flame	UL796	C	T
Typ	max(in)	mm(in)	mic(mil)	DSO	mm(in)	C	sec	C	Class	DSR	I
<b>Hull/Bayer (mass laminate) printed wiring boards.</b>											
<b>O-LEADING-401</b>											
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
<b>O-LEADING-407</b>											
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.2 (0.4)	260	10	170	V-0	NI	-
<b>Hull/Bayer printed wiring boards.</b>											
<b>O-LEADING-408</b>											
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) 31(1.25)	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	NI	*
<b>Single layer printed wiring boards.</b>											
<b>O-LEADING-002</b>											
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	NI	-
<b>O-LEADING-003</b>											
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
<b>O-LEADING-033</b>											
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	S5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI	-
<b>O-LEADING-205</b>											
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-
<b>O-LEADING-206</b>											
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-

\* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.  
 Last updated on 2017-01-27

Questions? [Print this page](#) [Terms of Use](#) [Page Top](#)

[http://www.ul.com/ulcertification/UL60716RMS/awg/ul/Prod/ZPMV2.E490354/awg/ul/Prod/Wiring,Printed-Component/17](#)

**Test Report** No. CANEC1805164701 Date: 03 Apr 2018 Page 2 of 8

Test Results:

**Test Part Description:**

**Specimen No.** SH1  
**SGS Sample ID** CAN18-051647.001  
**Description** Green "PCB"

**Remarks:**

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%  
 (2) MDL = Method Detection Limit  
 (3) ND = Not Detected (< MDL)  
 (4) \* = Not Regulated

**RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU**

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det?
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND

Member of the SGS Group (SGL SA)

# Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM Leiterplattenhersteller
Lieferungsdetails	7-12days

☐ **GOLDENER FINGERPLATTE Lieferant** ☐



## FAQ

1. Wie sichert O-Leading Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit folgendem erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach ISO 9001: 2008 Standards kontrolliert.
2. Umfassender Einsatz von Software zur Verwaltung des Produktionsprozesses
3. Stand der Technik Testgeräte und Werkzeuge. Z.B. Flying Probe, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
4. engagiertes qualitätssicherungsteam mit fehlerfallanalyseprozess
5. Kontinuierliche Schulung und Schulung des Personals

2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

Im letzten Jahrzehnt hatten sich die Preise vieler Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Chinesische Währung RMB hatte 31% gegenüber dem US-Dollar aufgewertet; Und unsere Arbeitskosten sind auch deutlich gestiegen. O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies trägt ganz zu unseren Innovationen bei der Kostenreduzierung, der Vermeidung von Verschwendung und der Verbesserung der Effizienz bei. Unsere Preise sind in der Branche auf dem gleichen Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide

Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Kosten- und Qualitätsvorteil bieten können.

3. Welche Arten von Boards können von O-Leading verarbeitet werden?

Gängige FR4-, High-TG- und halogenfreie Platinen, Rogers, Arlon, Telfon, Platinen auf Aluminium- / Kupferbasis, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenproduktion benötigt?

Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Materialschneiden → Innerer Trockenfilm → Inneres Ätzen → Inneres AOI → Multi-Bond → Schichtstapel Pressen → Bohren → PTH → Plattieren → Äußerer Trockenfilm → Musterplattieren → Äußeres Ätzen → Äußeres AOI → Lötmaske → Bauteilmarkierung → Oberflächenfinish → Routing → E / T → Sichtprüfung.